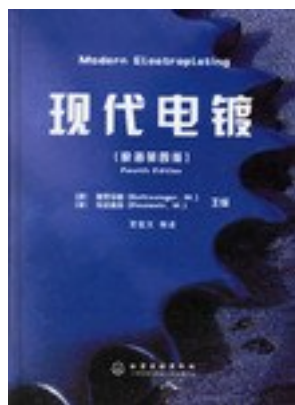


现代电镀



[现代电镀 下载链接1](#)

著者:M.) 施莱辛格 (Schlesinger

出版者:化学工业出版社,工业装备与信息工程出版中心

出版时间:2006-8

装帧:精装

isbn:9787502590307

第三版《现代电镀》的出版已经过了四分之一个世纪，电化学沉积已发展成为一门具有许多新的和潜在应用的成熟学科。为了描述这些发展，第四版《现代电镀》邀请来自加拿大、美国、日本、德国等地专家（完全有别于第三版作者），向读者呈现了一本完整的电镀专著。新版涉及到广泛的边缘课题，从半导体的电镀到环境研究。第四版适合于有电镀实践经验的专业人员，也适合于初学者。它提供了清晰、完整、最新的原理解释，以及密切相关的电镀技术的应用，它不仅替代第三版成为电镀工艺的一个非常有效的资料来源，而且重点转移到电子工业，从物理方法到电化学方法，特别是关于第二代产品技术，如铜互连技术。内容包括：各种金属及合金的电镀 半导体的电镀和绝缘体的电镀 导电性聚合物的电沉积 各种金属及合金的化学镀 镀前预处理工艺 生产技术，监测、试验和控制 电镀与环境

作者介绍:

目录:

[现代电镀_下载链接1](#)

标签

评论

[现代电镀_下载链接1](#)

书评

[现代电镀_下载链接1](#)